

株式会社東京精密 2024年度(2025年3月期) 第3四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2025年2月4日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2024年度(2025年3月期) 第3四半期 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
 - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
 - なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。
1. 10-12月期 SPE 受注高の想定比上振れ要因と上振れ幅を確認したい。また、2025年度上期以降の SPE 受注の持続性についても確認したい。
 - 10-12月期の SPE 受注は、生成 AI 関連のロジック、メモリ関連需要に加え、HPC 関連需要が堅調で、想定を 10%程度上振れる着地となった。
 - なお、2024年度下期の生成 AI 関連受注は、11月時点で上期比 20%~50%増と想定をしていたが、現時点では 50%増の想定。結果、下期の SPE 受注ガイダンスを、11月想定比で引き上げている。
 - 2025年度上期について、生成 AI ならびに HPC 関連の受注は、2024年度下期比で 30%程度増加を想定している。
 2. 11月時点と比較し、生成 AI 需要の見通しが引きあがったと考えられる。事実なら、それが AI パッケージング需要、HBM のテスト需要、どちらによるものか確認したい。
 - 両方において、見通しを同水準引き上げている。
 - なお、2024年度通期の業績予想を修正しているが、これは OSAT における HPC 向けのプローバの事業機会が増え、一部が 2024年度に寄与することを想定したものである。
 3. 生成 AI に関する 2024年度下期の売上規模や今後の見通しを確認したい。
 - 2024年度下期の生成 AI 関連売上高は、上期比で 20%程度増加を想定。
 - 2025年度上期の生成 AI ならびに HPC 関連売上高は、2024年度下期比 45-50%程度の増加と想定している。
 4. 会社の生成 AI の事業機会は、HBM 向けプローバ、AI パッケージング用のグラインダと認識しているが、この見方に変化はないか。

- それらに加え、足許では、HPCにおけるプロローバの事業機会が増加している。
5. 会社の生成 AI の事業機会は、HBM 向けプロローバが過半と認識していたが、この状況に変化はあるか。
- 現時点では、HBM 向けプロローバ、AI パッケージング用のグラインダの事業機会は、ほぼ半々になっていると考える。
6. 市場では、安価な AI LLM (大規模言語モデル)が発表されるなど、生成 AI に関するニュースフローが多い。これらによる影響や、装置需要の変化はあるか。
- 現時点では、新たな AI モデルの登場により市場がどう変化するか、判然としないところがある。少なくとも、当社の顧客需要の変化は感じていない。
7. 2025 年上期の SPE 受注水準についてどう考えるか。
- 2025 年度上期の SPE の受注水準は、ベースシナリオで 2024 年度下期比 5%増以上である。
 - 生成 AI ならびに HPC 関連の需要が、前述の通り 30%程度の増加を想定する一方で、SiC などの減速を想定したものである。
 -
8. 10-12 月期の全社売上総利益率(43.3%)は、従前から改善している。製品ミックスが採算に寄与しているといったことはあるか。
- 当社は、むしろ 4-12 月期累計売上高が既往ピーク水準にありながら、部材価格や物流費などの高騰などを主因に各利益が既往ピーク水準に届いておらず、改善策として利益率を 5 ポイント程度高めることをゴールとした原価低減活動を進めている。
 - 10-12 月期の利益率は、その原価低減活動の成果が一部寄与していると認識している。製品ミックスの影響は少ない。
9. 足許のパワー半導体、ならびに SiC 関連装置需要について伺いたい。
- 一定の数字が計上されているが、感覚的には減速を感じている。2024 年度下期の SiC 関連受注高は、上期比で半減を想定しており、今後 1 年程度は軟調な受注環境を見込んでいる。
 - なお、Si パワー半導体に関しては、中国等での長納期案件の出荷がコンスタントに進んでいる。
10. 中国 SPE 需要の持続性に関する見解をいただきたい。
- SiC 需要が減速基調になる中でも、当社 SPE の中国向け比率は 30%台後半と、

高水準を維持している。これはプローバやダイサの需要が堅調であるためで、生成 AI 向けと推定される案件も存在する。

- 1年以上先には、中国比率が20%台まで低下する局面が訪れる可能性もあると考える。もっとも、その場合でも地政学リスク回避の観点で増加する東南アジアなどの需要が補完すると考える。

11. プローバの生産稼働率に関する情報をいただきたい。

- 足許では最大生産量の3分の2程度の生産となっており、需要増加局面でも対応できると考えている。

12. CMP 装置の事業動向について解説いただきたい。

- ここ10年、コンスタントな出荷が続き、黒字体制を維持している。
- SiC 向けは、市場減速に伴う需要減の可能性はあるが、CMP 工程そのものが、従前使用していなかった工程にも広がっている。当社 CMP 装置は、こういった要求技術の変化に伴い、絶えずマイナーチェンジを行っている。
- また、CMP 装置に付帯される洗浄装置は、Hybrid Bonding 向けグラインダに搭載可能である。この点は優位性につながる。

13. Hybrid Bonding 用のグラインダについてアップデートがあれば共有いただきたい。

- 既に発注済のケース、評価機納入、リピート発注を受けたケースがある。
- これらを総合的に勘案すると、Hybrid Bonding に関するパイロットラインでの生産が2025年度中に始まり、2026年度以降普及してゆくものと想定している。
- NAND 関連顧客からも、Hybrid Bonding の適用を示唆するコメントをいただいていることから、市場の拡大に強く期待している。

14. 2025 年度に向けた、各製品の方向感を確認させていただきたい。

- プローバは引き続きデパート化戦略を継続する中、従前より説明している高精度温度制御がポイントとなっており、引合が堅調な要因の一つとなっている。
- グラインダは、コンスタントに発注を受けており、今後とも、出荷が続いていくものと想定。
- 計測では、充放電試験システムの売上高が、同セグメントの2024年度下期売上の10%程度を占めるようになっており、今後も増加基調が想定される。

15. 会社は5月に新たな中期経営計画を発表するとしている。この計画における重点ポイントや、成長が期待される分野に関してコメントをいただきたい。

- 現中期経営計画(2022年度-2024年度)の定量目標が未達見込みの中では、数字目

標にこだわる計画を策定したいと考えている。

- その上で、プローバは全方位戦略、**Hybrid Bonding**、ならびにレーザダイサなどが業容拡大のけん引役になるし、また、民生アプリケーション需要・パワー半導体需要の回復における底上げにも強く期待している。
- これらの数字を積み上げ、一定の定量目標を達成する計画としたい。

以上